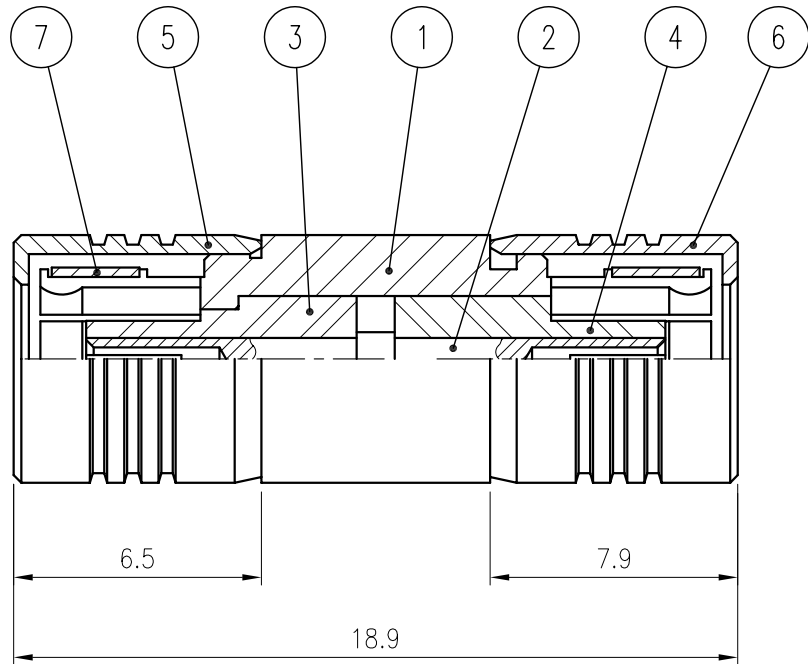


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										△				
ST(개선)										△				



7	SPRING RING	2	BeCu	Gold Plate	DSR00004-N45/1 (R3001) DSR00004-5/2 (R3001)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU02152-5/1
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00021-135/1 (K3001)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00331-N/1 (H3045)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00332-N/1 (H3044)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00341-1345/1 (E3035)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00429-135/1 (D3039)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	1999. 7. 23.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
	검도						
재질	재도				도명 SMB-A-FF		
열처리	작성부서						
보호파막처리	연 구 소			A4	도번 AD00038-7/1 K315-704-000		
	척도 5/1	단위 mm	중량				